

PCN # 20140917001
一部製品 BSL Firmware 変更 / TSMC-F10 社 (Fab 10) 前処理サイト追加

お客様各位

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

PAGE 2:

Attachment: 1

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。変更内容詳細は下記を参照ください。

PCN 番号:	20140917001	PCN 日付:	09/19/2014									
表題:	一部製品 BSL Firmware 変更/TSMC-F10 社(Fab 10)前処理サイト追加											
PCN 詳細												
変更内容:												
本変更通知は、本通知product affected セクション記載の製品について、BSL Firmware変更、及び追加前処理サイト(Wafer Fab site)オプションとして、TSMC-F10社(Fab 10)サイト追加を連絡するためのものです。												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Current Wafer Fab Site</th> <th>Process</th> <th>Wafer Diameter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TSMC-WF3 (Fab 3)</td> <td>0.18 Embedded Flash</td> <td>200mm</td> </tr> <tr> <td>TSMC-WFT (Fab 11)</td> <td>0.18 Embedded Flash</td> <td>200mm</td> </tr> </tbody> </table>				Current Wafer Fab Site	Process	Wafer Diameter	TSMC-WF3 (Fab 3)	0.18 Embedded Flash	200mm	TSMC-WFT (Fab 11)	0.18 Embedded Flash	200mm
Current Wafer Fab Site	Process	Wafer Diameter										
TSMC-WF3 (Fab 3)	0.18 Embedded Flash	200mm										
TSMC-WFT (Fab 11)	0.18 Embedded Flash	200mm										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Additional Fab Site</th> <th>Process</th> <th>Wafer Diameter</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TSMC-F10 (Fab 10)</td> <td>0.18 Embedded Flash</td> <td>200mm</td> </tr> </tbody> </table>				Additional Fab Site	Process	Wafer Diameter	TSMC-F10 (Fab 10)	0.18 Embedded Flash	200mm			
Additional Fab Site	Process	Wafer Diameter										
TSMC-F10 (Fab 10)	0.18 Embedded Flash	200mm										
BSL Firmware Change:												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Description of Change</th> <th>Benefit of Change</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Errata BSL 6 Errata BSL 7 Errata USB 11</td> <td>Reduced errata</td> </tr> </tbody> </table>				Description of Change	Benefit of Change	Errata BSL 6 Errata BSL 7 Errata USB 11	Reduced errata					
Description of Change	Benefit of Change											
Errata BSL 6 Errata BSL 7 Errata USB 11	Reduced errata											
変更理由:												
供給確保												
外観, 寸法, 機能, 品質, 信頼性(positive / negative)に関する懸念事項:												
なし												

注記)

- 本資料は英語原文(一部)の日本語訳になりますが、TIの公式文書はあくまで英語原文になります。英語原文と日本語訳に齟齬がある場合には、英語原文が優先されます。
- 上記項目以外、本資料に日本語訳が記載されていない項目については英語原文を参照ください。

原文のみ記載の項目例:

- **Proposed 1st Ship Date** (変更品出荷開始予定日)
- **Last date to order / Last date to ship** (最終受注日/最終出荷日)
- **Estimated Sample Availability** (サンプル入手可能予定時期)
- **Change Type** (変更項目タイプ)
- **Changes to product identification resulting from this PCN** (本変更による製品識別の変更)
- **Product Affected** (対象製品)
- **Qualification Data** (認定試験データ)
- **Appendix** (付属資料) 等